



BO-JIANG

帛江科技股份有限公司

BO-JIANG TECHNOLOGY CO., LTD.

PRODUCT SPECIFICATION (產品規格書)

PART NO.(圖號)	7865NR502BD001R	DATE (日期)	2008/03/17
--------------	-----------------	-----------	------------

TITLE(產品名稱)	SMA R/A PCB MOUNT JACK		
-------------	------------------------	--	--

MATERIAL AND FINISH(材質及表面處理)

DESCRIPTION(名稱)	MATERIAL(材質)	FINISH(表面處理)
Center Contact(中心導體)	PHOSPHOR BRONZE	30u"GOLD
Insulator(絕緣體)	TEFLON	WHITE
Outer Contact(外導體)	BRASS	3u"GOLD
Others(其它)		

ELECTRICAL(電氣特性)

項目	測試條件	測試規格	
Impedance(阻抗)	0~12.4 GHz	50 Ω	
Voltage Standing Wave Ratio(VSWR)(駐波比)	0~12.4 GHz	1.5 Max.	
Dielectric Withstanding Voltage(絕緣耐電壓)	DC 1000 V, time: 60sec	1000 Volts Min. RMS	
Contact Resistance (導體阻抗)	Center Contact (中心導體)	DC 0.2V, 1A	6 Milliohms Max.
	Outer Contact(外導體)	DC 0.2V, 1A	2 Milliohms Max.
Insulation Resistance(絕緣阻抗)	DC 500V, time: 60sec	5000 Megohms min.	

MECHANICAL(機械特性)

項目	測試條件	測試規格
Force To Engage/Disengage(接合力/脫離力):	N/A	2 in-lbs. max.
Coupling Nut Retention(聯結螺帽承受力):	60mm/min	N/A
Coupling Proof Torque(聯結承受扭力):	N/A	N/A
Contact Retention(中心導體承受力):	60mm/min	6 lbs. min.

REMARKS(備註)

A1	N/A			Alicia
Issue 版本	Revision 修改記錄	Approved 核准	Checked 審核	Drawn 製定